

会社概要 (2022年12月31日現在)

社名	レーザーテック株式会社
所在地	〒222-8552 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目10番地1
設立	1962年8月
資本金	9億3,100万円
主な事業内容	下記製品の開発・製造・販売・サービス 1. 半導体関連装置 2. エネルギー・環境関連製品 3. レーザー顕微鏡関連製品 4. FPD関連装置
従業員数	連結 752名 単体 384名
お問い合わせ先	045-478-7127 (経営企画部)

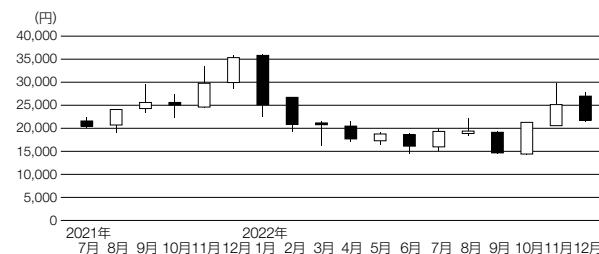
株式情報 (2022年12月31日現在)

株式概要

上場市場	東京証券取引所プライム市場
発行済株式総数	94,286,400株
株主数	39,105名
大株主一覧	持株数(千株) 持株比率(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	12,807 14.20
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	4,486 4.97
内山 秀	4,288 4.75
内山 洋	3,970 4.40
前田 せつ子	3,137 3.47
株式会社三菱UFJ銀行	3,008 3.33
CITIBANK, N.A. - NY, AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY SHARE HOLDERS	2,755 3.05
JP MORGAN CHASE BANK 385632	2,730 3.02
BBH FOR UMB BANK, NA - WCM FOCUSED INTERNATIONAL GROWTH FUND	1,975 2.19
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234	1,498 1.66

(注) 1. 当社は、自己株式を4,102千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。また持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
2. 持株・持株比率は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

株価の推移



取締役および監査役

取締役 会長執行役員 楠瀬 治彦	代表取締役 社長執行役員 岡林 理	取締役 専務執行役員 森泉 幸一
取締役(社外) 三原 康司 上出 邦郎 岩田 宣子	常勤監査役 浅見 公一	監査役(社外) 石黒 美幸 出雲 栄一

株主メモ

事業年度	7月1日から翌年6月30日まで
定時株主総会	毎年9月
基準日	毎年6月30日(なお、その他必要あるときは、あらかじめ公告した日)
単元株式数	100株
株主名簿管理人	三井住友信託銀行株式会社
特別口座管理機関	(同上)
同連絡先	三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-782-031 (通話料無料) 郵送先 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

公告掲載URL <https://www.lasertec.co.jp>

ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。

(ご注意)

- 株主さまの住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、口座を開設されている口座管理機関(証券会社など)にお問い合わせください。株主名簿管理人(三井住友信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
- 特別口座に登録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三井住友信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座管理機関(三井住友信託銀行)にお問い合わせください。なお、三井住友信託銀行全国各支店においてもお取り扱いいたします。
- 未受領の配当金につきましては、三井住友信託銀行の本支店でお支払いいたします。

当社Webサイトのご案内
<https://www.lasertec.co.jp/ir/>

日興アイ・アール株式会社の「2022年度 全上場企業ホームページ充実度ランキング」にて総合部門最優秀サイトに選ばれました。



▼ Gomez / IRサイト総合
ランキング銅賞(2022年)



株主通信

Lasertec News 28

第61期
第2四半期累計期間
2022年7月1日▶
2022年12月31日

C create
U nique S olutions.
C create
N ew V alue.

Lasertec

証券コード6920



代表取締役 社長執行役員 岡林 理

中長期を見据え、さらなる成長への布石を

第2四半期連結累計期間の業績報告

株主の皆さまには、日頃よりご支援とご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

当第2四半期連結累計期間における世界経済は、ウクライナ危機に端を発した資源・エネルギー価格の高騰によるインフレや、欧米を中心とした急激な政策金利の引き上げと為替変動などで不確実性が高まり、景気減速が懸念される状況が続きました。

当社グループの主要販売先である半導体業界では、コロナ禍で拡大したスマートフォンやパソコン向けの半導体需要が一転して大幅な減少に見舞われ、メモリデバイスメーカーを中心として設備投資を縮減する動きが広がりました。ロジックデバイスメーカーにおいても、最先端のEUV（極端紫外線）リソグラフィを用いた半導体製造能力の増強などで高い水準の投資を維持したものの、短期的には従来の投資計画を一部先送りする動きが

見られました。しかし、今後拡大が見込まれる半導体需要ならびに懸念が高まる地政学リスクに対応するため、世界各地における半導体工場の新設や増設に関する計画が発表されており、半導体関連装置市場は引き続き中長期的な成長が見込まれています。

このような状況下、当第2四半期連結累計期間の売上高は551億円（前年同期比49.2%増）、営業利益は181億24百万円（同41.6%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益が135億82百万円（同39.5%増）となり、売上、利益のいずれも上半期の過去最高を更新することができました。

通期の見通しについては、期初予想から変更はなく売上高1,400億円、営業利益420億円、親会社株主に帰属する当期純利益330億円を見込んでいます。

第2四半期連結累計期間の受注状況

当第2四半期連結累計期間の受注高は943億83百万円となりました。半期で過去最高だった前年同期の受注高を大幅に下回りましたが、EUVマスク関連製品は堅調に推移するとともに、パワーデバイス関連製品が大きく伸張し、半期では過去3番目に高水準の受注となりました。

中期経営計画フェーズ3+（プラス）*

当期は中計フェーズ3+の2年目です。2019年以降、コロナ禍における半導体の供給不足とスマートフォンやパソコン向けの特需などもあって半導体市場の

好調が続いていましたが、2022年の途中から市況が悪化し、2023年には4年ぶりにマイナス成長になると見込まれています。半導体関連装置市場においても拡大一辺倒から調整色が強まり、当社の上半期には投資計画の見直しをする動きが目立ちました。しかしながら、今後も半導体市場は拡大を続けるとともに、半導体製造技術のさらなる高度化が進むことで、当社にとって中長期的に大きな成長の機会もたらされるという見方に変わりはありません。下半期には引き続きEUV関連などの先端分野に注力し、「成長を支える基盤強化」に努めるとともに、お客さまのご要望と市場の変化に即応して最先端ソリューションをタイムリーに提供することで、より多く社会に貢献しつつ事業の成長を目指してまいります。

中間配当

中間配当額は、前期中間配当より20円増配の52円といたします。期末配当は77円（前期比12円の増配）を予想しており、年間では129円（前期比32円の増配）となる見込みです。

レーザーテックは、「世の中になくのものをつくり、世の中のためになるものをつくる」を経営理念として、当社の強みである光技術を生かしたビジネスを通じて世の中に貢献し、業績の向上につなげてまいります。

株主の皆さまにおかれましては、今後とも一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

* 2021年7月から2024年6月までの3カ年中期経営計画。

業績ハイライト

前年同期比 49.2% ↗ 売上高 **551** 億円

前年同期比 41.6% ↗ 営業利益 **181** 億 24 百万円

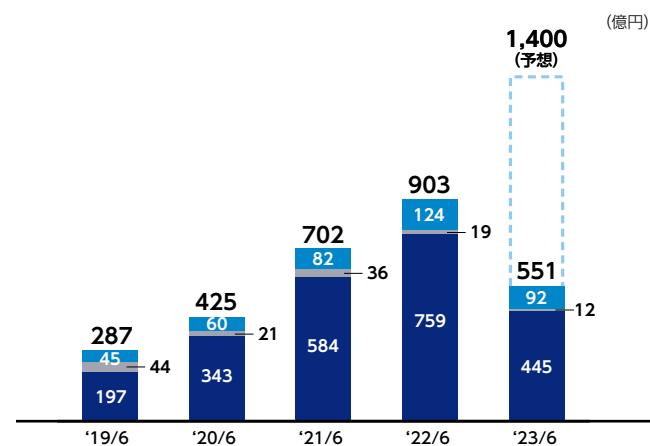
前年同期比 △47.2% ↘ 受注高 **943** 億 83 百万円

前年同期比 39.5% ↗ 親会社株主に帰属する 四半期純利益 **135** 億 82 百万円

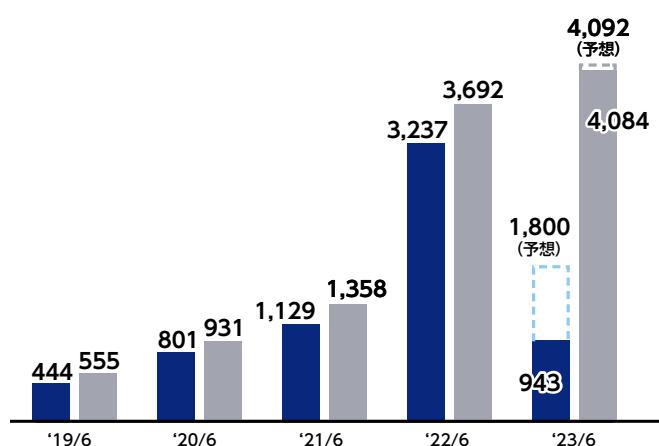
自己資本 **803** 億 57 百万円

資産合計 **2,413** 億 88 百万円

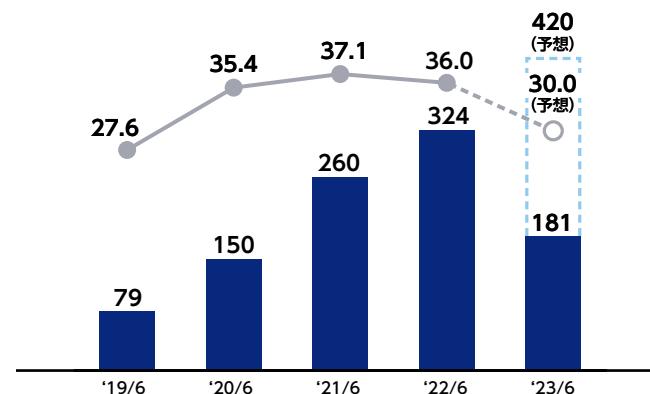
製品別売上高* ■ 半導体関連装置 ■ その他 ■ サービス



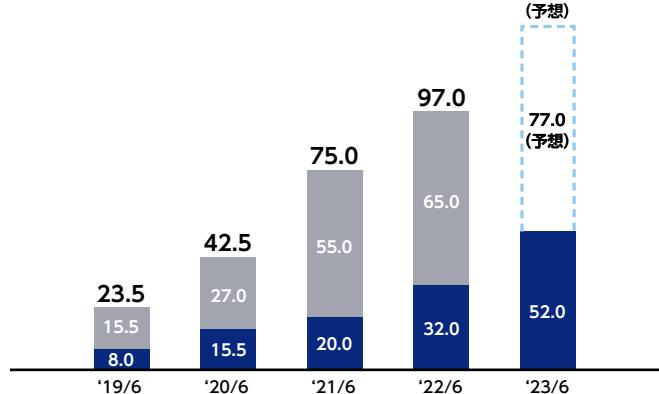
■ 受注高* ■ 受注残高*



■ 営業利益* ● 営業利益率*

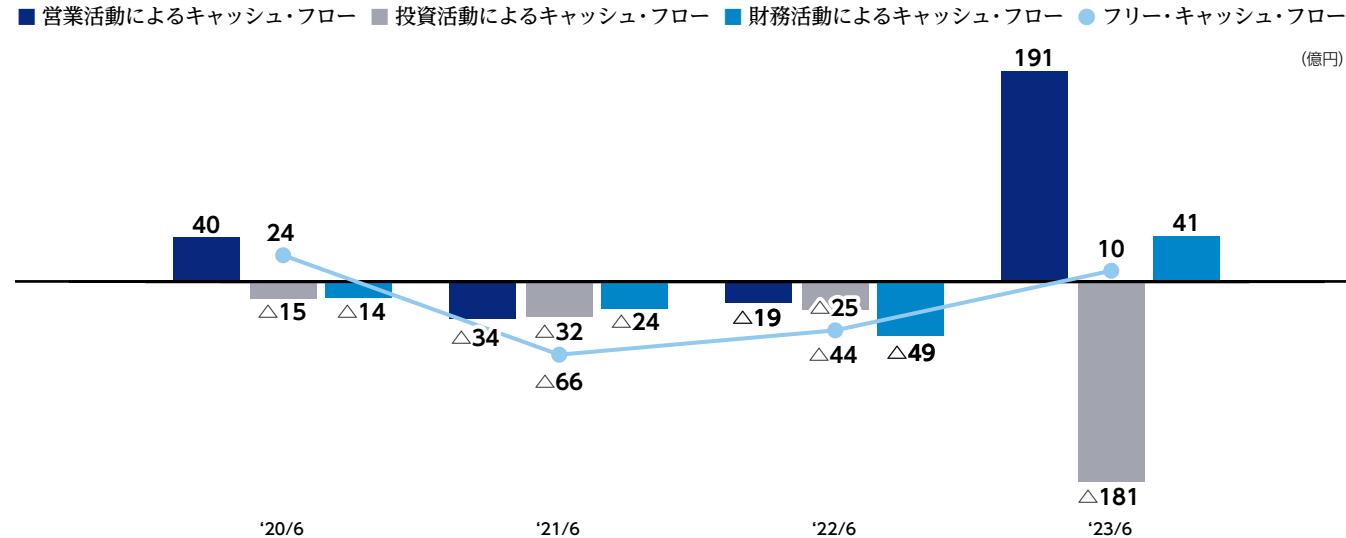


1株当たり配当金 ■ 中間 ■ 期末



(注) 2020年1月1日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施いたしました。経年比較のため、上記の金額は2019年6月期の期首にこの株式分割が行われた仮定で算出しております。

キャッシュ・フロー (第2四半期連結累計期間)



決算のポイント

純資産合計

株主資本にその他の包括利益累計額および新株予約権を加えた純資産合計は803億79百万円となり、自己資本比率は33.3%となりました。

売上高/利益

お客さま先で稼働する製品台数の増加に伴いサービス売上が堅調に拡大し、売上高・利益は上半期における過去最高を更新しました。

営業活動によるキャッシュ・フロー

前受金の増加、税金等調整前四半期純利益などの収入要因が、棚卸資産の増加、売上債権の増加などの支出要因を上回りました。

2022 9/30

新研究開発拠点(新横浜)の名称決定、建設開始

2022年2月に取得を発表した新拠点の名称が、Lasertec Innovation Park (通称:InnoPa (イノパ)) に決定しました。本拠点の新設は、将来を見据えた業容拡大への対応、業務効率の向上と経営基盤の強化を目的としたものです。まずは、検査装置の新たな生産拠点として、クリーンルームを含む設備の建設を開始しました(第1期工事の完成予定は2023年6月末)。今後は、当社事業の成長に即した研究開発、執務場所および倉庫としての活用を検討していきます。

なお、2022年9月30日をもって当社所有物件となりましたが、機械実習棟を除き2023年9月30日を期限とし、当面は東芝グループの利用が継続されます。

2022 11/1

「半導体気候関連コンソーシアム(SCC)」に加入

国際半導体製造装置材料協会(SEMI)が、サステナブル社会の実現を目指した気候変動改善への取り組みとして設立した「半導体気候関連コンソーシアム(SCC)」に、創設メンバー企業として参加しました。SCCの設立にあたっては、Intel Corporation、Samsung Electronics、TSMC(台湾積体回路製造)など半導体メーカーのお客さまをはじめとして、Applied Materials、ASML、Lam Research、東京エレクトロンなど多くの半導体製造装置メーカーが名を連ね、グローバルで全65社が参加しました。当社はこれらSCCメンバー企業との協働により、半導体のバリューチェーンにおける気候変動に対する取り組みを推進していきます。



2022 12/1

新製品「CIRIUS」「CIEL」同時発売

高集積化が進むメモリなどで課題になっているデバイス内部の欠陥を、高感度に検査/レビューできる高感度内部欠陥検査/レビュー装置「CIRIUS」シリーズを発売しました。独自の光学技術により、内部欠陥の検査だけでなく、深さ位置の特定と分類を実現した装置で、半導体製造プロセスの歩留まり改善による生産コスト低減に貢献します。

また、「CIRIUS」シリーズと同時に発売した高感度ウェハエッジ検査装置「CIEL」シリーズは、半導体デバイスの微細化や高積層化に伴い課題となったウェハエッジを発生源とする欠陥をターゲットにした製品です。ディープラーニング(深層学習)技術を用いた高精度な欠陥分類と、独自光学系の3D機能によって高さ・深さ情報を含む高解像度画像の取得を可能とし、歩留まりを低下させる欠陥を特定する機能を充実させました。



2022 12/14 ~ 16

SEMICON Japan(半導体製造装置・材料の国際展示会)に出展

2022年は世界の半導体業界に注目が集まった年であり、日本においても4月に開始したTSMC 熊本工場の建設や、10月に発表された最先端半導体(2nm世代プロセス)の量産を目指す「Rapidus(ラピダス)」の設立など、半導体業界が活発な動きを見せました。同年12月に開催された第46回SEMICON Japanでは開催史上初めて現役首相が開会式であいさつするなど、半導体業界への注目度の高さがうかがえました。当社ブースでは新製品やEUV関連装置の紹介、顕微鏡のデモ展示などを行い、連日多くの皆さまに来訪いただきました。

